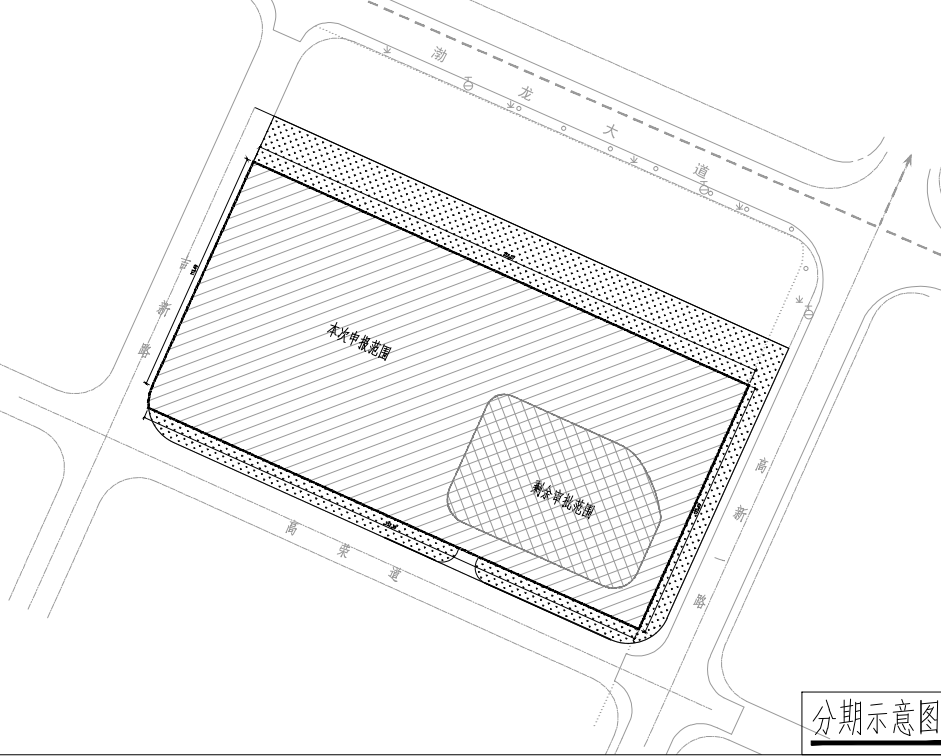


半导体新材料氧化镓研究与产业化项目建筑设计方案

总平面图草案公示

公示单位：天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局
联系人：马梁 联系电话：84800040
编制单位：天津中高芯材半导体科技有限公司
联系人：田丽萍 联系电话：15522547986
设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
联系人：陈雪莲 联系电话：15022775870

技术指标参考标准 (6类, 工业类)				
项目	单位	总指标	已发证指标	本次申请指标
总用地面积	m ²	32000.00	0.00	26187.20
界内建设用地面积	m ²	32000.00	0.00	26187.20
容积率	-	1.05	0.00	0.00
地上总建筑面积	m ²	≤ 33544.59	≤ 0.00	≤ 26298.11
建筑密度	%	≤ 35.00%	0.00%	≤ 9331.45
建筑基底面积	m ²	≤ 11200.63	≤ 0.00	≤ 1869.18
绿地率	%	≥ 20.00%	0.00%	≥ 2440.00
绿地面积	m ²	≥ 6400.00	≥ 0.00	≥ 3960.00
项目	单位	指标	≤	≥
总建筑面积	m ²	18662.75	≤	18662.75
地上建筑面积	m ²	18522.83	≤	18522.83
其中	地上计容建筑面积	m ²	≤	26298.11
	地上计容建筑面积	m ²	≤	0.00
	地上计容建筑面积	m ²	≤	0.00
	地上计容建筑面积	m ²	≤	0.00
	地上计容建筑面积	m ²	≤	0.00
	地上计容建筑面积	m ²	≤	0.00
地下建筑面积	地下建筑面积	m ²	≤	0.00
	地下建筑面积	m ²	≤	139.92
	地下建筑面积	m ²	≤	63 (11.11% 容积率)
其中	地上建筑面积	m ²	≤	63 (11.11% 容积率)
	地上建筑面积	m ²	≤	0
	地上建筑面积	m ²	≤	0
其中	地上建筑面积	m ²	≤	50
	地上建筑面积	m ²	≤	50
	地上建筑面积	m ²	≤	0
其中	地上建筑面积	m ²	≤	1869.18
	地上建筑面积	m ²	≤	5.84%
	地上建筑面积	m ²	≤	3959.70
	地上建筑面积	m ²	≤	14.68%
	地上建筑面积	m ²	≤	2457.02
其中	地上建筑面积	m ²	≤	9.11%
	地上建筑面积	m ²	≤	9.11%



图例	线型	图例	线型
用地红线	———	步行铺装	———
新建道路	———	硬化铺装	———
市政道路	———	管廊	———
新建围墙	———	访客出入口铺装	———
建筑轮廓线	———	路缘石范围	———
厂区绿化	———	室外地沟位置	———
光伏车棚	———	二期分界线	———

总平面图 1:500